マニュアルダイボンダ

LED や IC ベアチップなどの半導体部品を回路基板上に実装するために用います。

[型式]

WEST BOND 社　MODEL　7200CR

[仕様]

ボンディング方式	: 荷重圧着方式
操作方法	: X-Y-Z　3 軸マニピュレーター
荷重範囲	: 10g-75g
チップ供給	: トレーから供給
チップのピックアップ方式	: 吸引による方式

[設置年度]

2011 年度（平成 23 年度）

○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、電話（084-931-2402）でお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/29/setsubiriyo.html でご確認ください。

令和 6 年 7 月 30 日